

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】令和6年10月28日(2024.10.28)

【公開番号】特開2023-24891(P2023-24891A)

【公開日】令和5年2月17日(2023.2.17)

【年通号数】公開公報(特許)2023-032

【出願番号】特願2022-210574(P2022-210574)

【国際特許分類】

H 0 5 K 1/02(2006.01)

10

【F I】

H 0 5 K 1/02 C

【手続補正書】

【提出日】令和6年10月18日(2024.10.18)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

20

【特許請求の範囲】

【請求項1】

金属支持基板と、絶縁層と、導体層とを、厚さ方向一方側に向かってこの順で備え、前記導体層が、少なくとも一つの端子部と、当該端子部から延出する配線部とを含み、前記金属支持基板が、当該金属支持基板を前記厚さ方向に貫通し且つ前記絶縁層を介して前記端子部に対向する開口部を有し、

前記開口部が、前記厚さ方向一方側の第1開口周端縁と、前記厚さ方向他方側の第2開口周端縁とを有し、前記厚さ方向の投影視において、前記第2開口周端縁は、前記第1開口周端縁の外側に配置されて当該第1開口周端縁に沿って延び、

前記投影視において、前記第1開口周縁部の少なくとも一部が、前記端子部の内側に配置され、前記第2開口周縁部の少なくとも一部が、前記端子部の外側に配置されている、配線回路基板。

30

【請求項2】

前記端子部は、前記絶縁層側の第1導体層と、前記第1導体層上の第2導体層とを含む、請求項1に記載の配線回路基板。

【請求項3】

金属支持基板と、絶縁層と、導体層とを、厚さ方向一方側に向かってこの順で備え、前記導体層が、少なくとも一つの端子部と、当該端子部から延出する配線部とを含み、前記金属支持基板が、当該金属支持基板を前記厚さ方向に貫通し且つ前記絶縁層を介して前記端子部に対向する開口部を有し、

40

前記開口部が、前記厚さ方向一方側の第1開口周端縁と、前記厚さ方向他方側の第2開口周端縁とを有し、前記厚さ方向の投影視において、前記第2開口周端縁は、前記第1開口周端縁の外側に配置されて当該第1開口周端縁に沿って延び、

前記端子部は、前記絶縁層側の第1導体層と、前記第1導体層上の第2導体層とを含む、配線回路基板。

50